



Part No./型号: **H2016Y-606A0101-0301QD**

产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

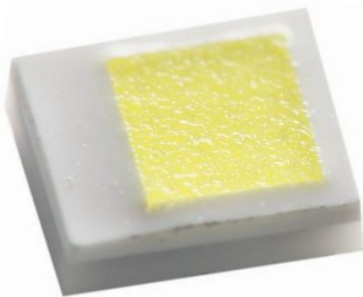
客户名称 Customer		
送样规格 Specification		
送样日期 Deliver Date		
基本参数 Basic parameters		参见规格书
特殊要求 Special Requirements		无
拟制 Issued	审核 Checked	批准 Approved 客户承认盖章 Customer Approved Signatures
		
客户使用条件及意见 Customer conditions and comments:		



Part No./型号: H2016Y-606A0101-0301QD

Flip chip 共晶 系列

产品介绍



本系列产品采用高可靠性氮化铝镀银陶瓷基板做衬底，具有亮度高、高密度、使用寿命长、功率多样、耐高压、光衰小、尺寸通用等特点，是适合室外、车灯等高要求产品的理想选择。

产品特点:

目录

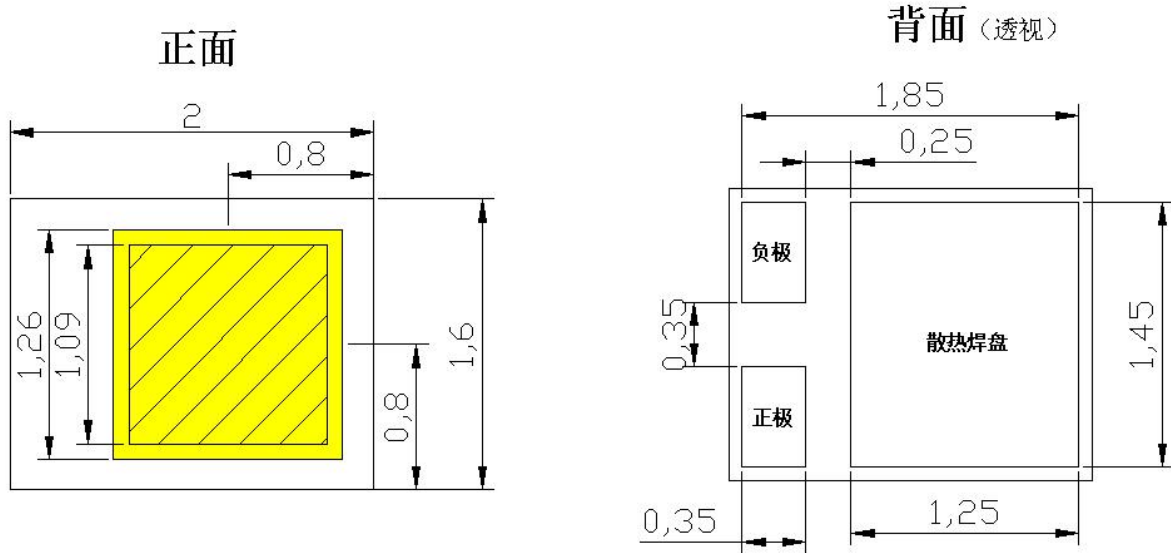
- ◇ 高亮度、高可靠性、高使用寿命
- ◇ 发光角度: 120°
- ◇ 符合ROHS 标准
- ◇ 使用共晶工艺

外形尺寸	3
电路结构.....	3
极限参数	4
光电参数	4
典型曲线	5
色坐标分档	7
可靠性测试	8
包装规范.....	9
推荐回流焊温度.....	11

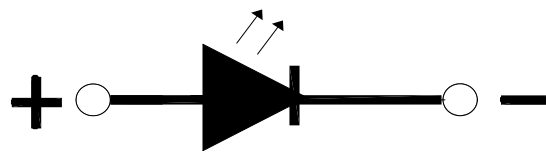


Part No./型号: **H2016Y-606A0101-0301QD**

外形尺寸



电路结构



1P1S

说明:

- ◇ 所有尺寸标注单位都是毫米
- ◇ 公差: >1mm (± 0.10), 0.1~1mm (± 0.05)
- ◇ 建议基板 T_s (焊盘) 的温度不要高于 100°C



Part No./型号: **H2016Y-606A0101-0301QD**

极限参数 (Ta = 25°C)

参数	符号	测试条件	参数		单位
			最小	最大	
直流电流	I _F	----	----	1000	mA
脉冲电流	I _{peak}	占空比=1/10 1kHz	----	1250	mA
最大功率	P _d	----	----	3.3	W
LED 结温	T _J	----	----	145	°C
工作环境温度	T _{opr}	----	-40	+100	°C
储存温度	T _{str}	----	-40	+100	°C
静电	----	HBM	2000	----	V

光电参数 (Ta = 25°C)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
正向电压	V _F	IF =700mA	--	3	--	V
光通量	Φ _v		260	265	--	lm
色温范围	CCT		5700	--	6000	K
			6000	--	6300	
		6300		6600		
热阻	R _J		--	5	--	°C/W



Part No./型号: **H2016Y-606A0101-0301QD**

典型曲线 :

Fig.1 正向电流 Vs. 正向电压

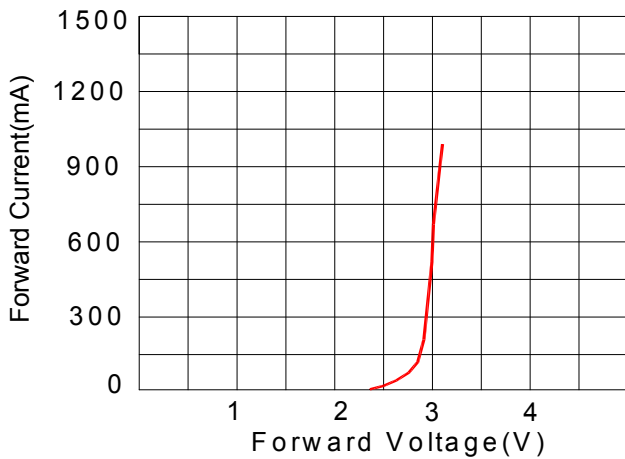


Fig.2 相对亮度 Vs. 正向电流

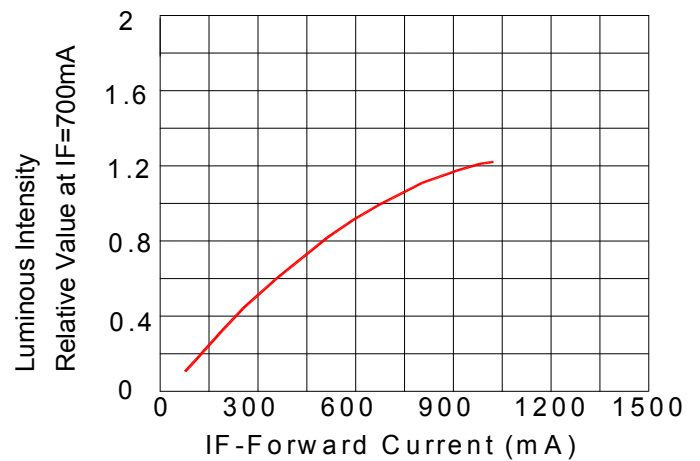


Fig.3 正向电流 Vs. 环境温度

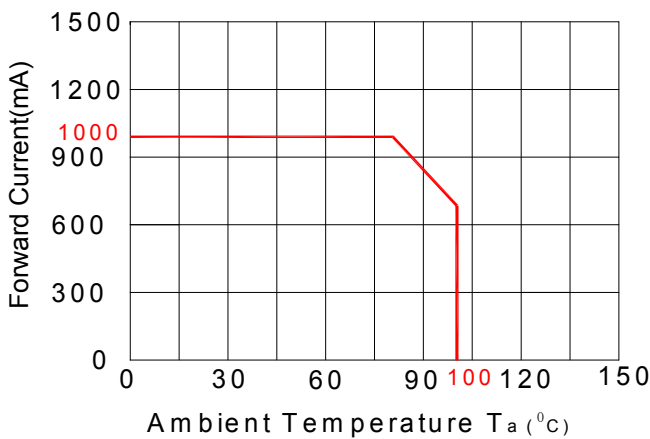
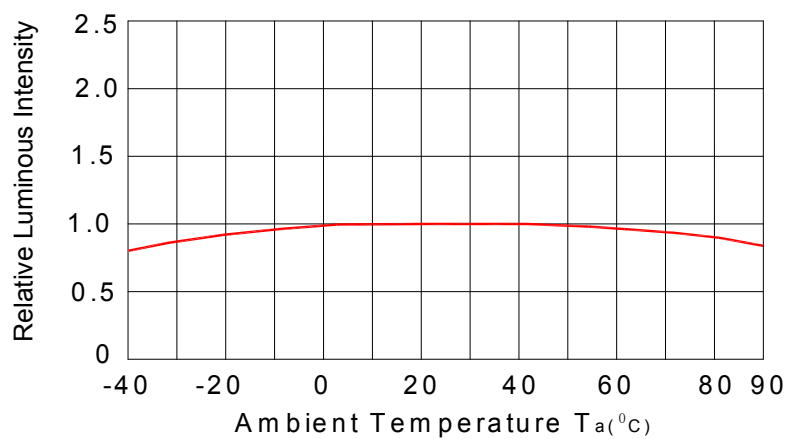
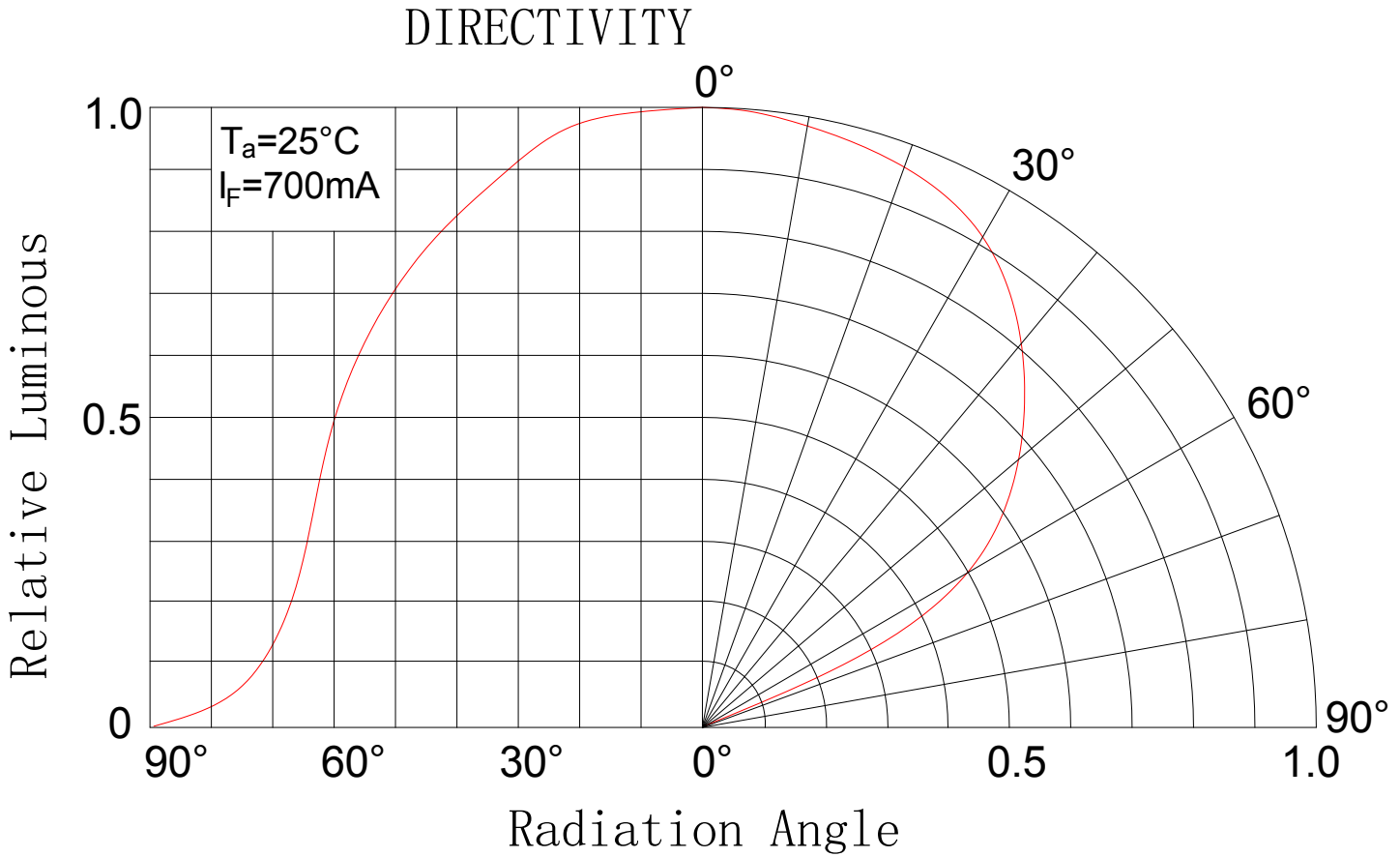


Fig.4 相对亮度 Vs. 环境温度





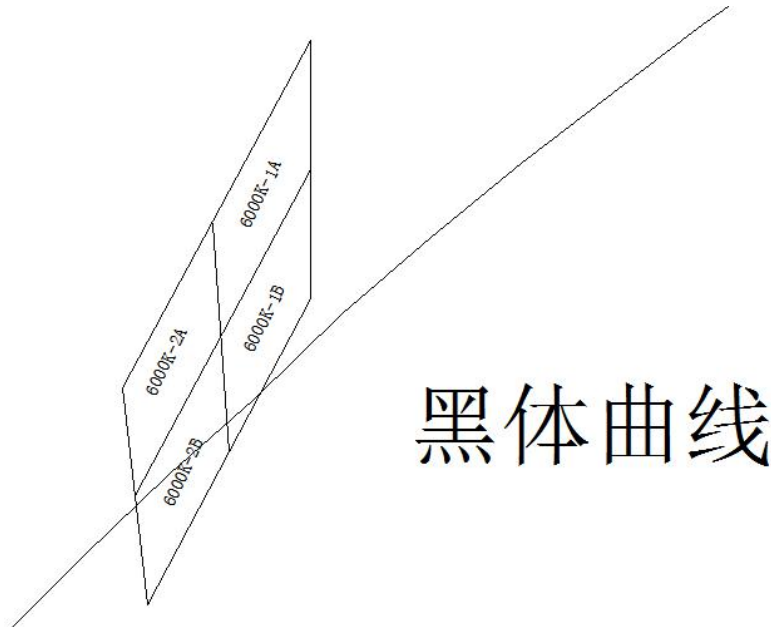
Part No./型号: **H2016Y-606A0101-0301QD**





Part No./型号: **H2016Y-606A0101-0301QD**

色坐标分档(I_F=700mA Ta=25°C)



	X	Y
6000K-1A	0.3216	0.3378
	0.321	0.3469
	0.3286	0.3612
	0.3286	0.3511

	X	Y
6000K-1B	0.3222	0.3287
	0.3216	0.3378
	0.3286	0.3511
	0.3286	0.3411

	X	Y
6000K-2A	0.315	0.3258
	0.314	0.3342
	0.321	0.3469
	0.3216	0.3378

	X	Y
6000K-2B	0.316	0.3173
	0.315	0.3258
	0.3216	0.3378
	0.3222	0.3287

说明:

1. 正向电压的测量公差是: $\pm 0.1V$
2. 光通量的测量公差是: $\pm 7\%$
3. 色温的测量公差是: $\pm 3\%$
4. 色坐标的测量公差是: ± 0.005



Part No./型号: H2016Y-606A0101-0301QD

可靠性测试

测试项目	参考标准	测试条件	测试周期	失效判定	失败/成功
回流焊	JESD22-B102	$T_{sld}=245\pm 5^{\circ}\text{C}$, 5sec, Lead-free solder(Sn-3.0Ag-0.5Cu)	5times	#1	0/10
温度循环	JESD22-A104D	-40°C (15min)~15min~ 100°C (15min)~15min~ -40°C	1000cycles	#1	0/10
高温高湿开关	JESD22-A101	$T_a=85^{\circ}\text{C}$, RH=85%, $I_F=1000\text{mA}$, 30min On/30min Off	1000H	#1	0/10
低温存储	JESD22-A119	$T_a=-40^{\circ}\text{C}$	1000H	#1	0/10
高温老化	JESD22-A108	$T_a=125^{\circ}\text{C}$, $I_F=1000\text{mA}$	1000H	#1	0/10
震动	JESD22-B103	200m/s^2 , 100-2000-100Hz, X、Y、Z 4min,4cycles	3times	#1	0/10

注意:

保证器件温度是室温的情况下进行测试

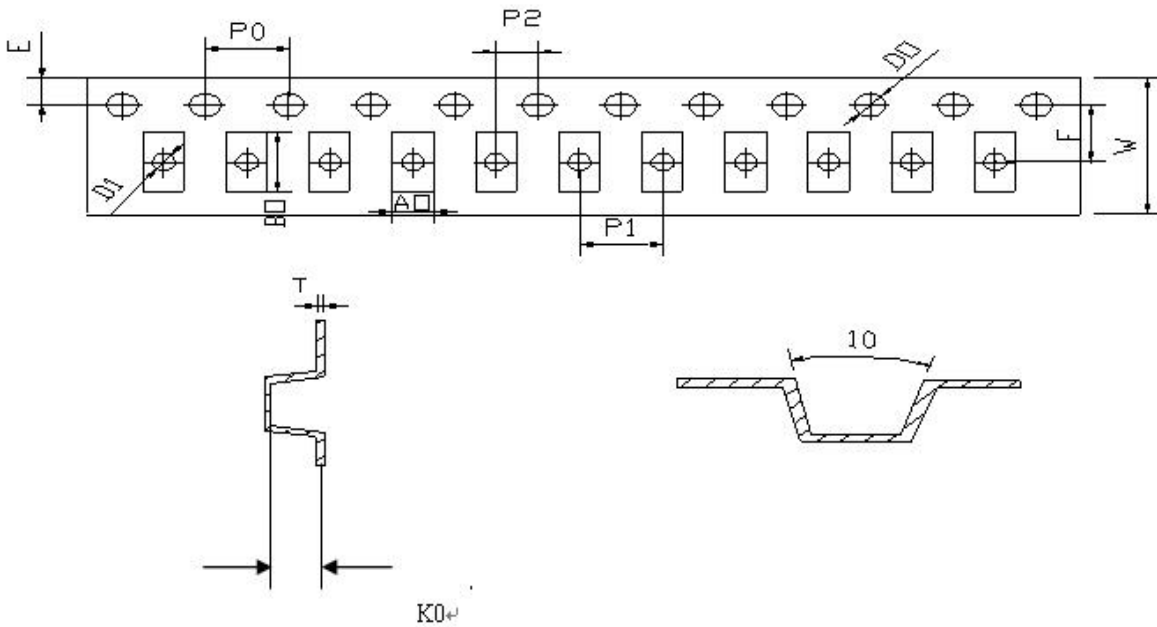
失效标准:

项目	条件	失效标准
正向电压 (V_F)	$I_F=700\text{mA}$	>起始值 x 1.1
光通量 (Φ_v)	$I_F=700\text{mA}$	<起始值 x 0.7

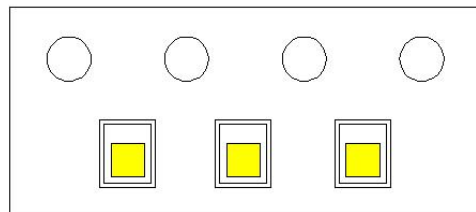


Part No./型号: **H2016Y-606A0101-0301QD**

包装规范 单位: mm

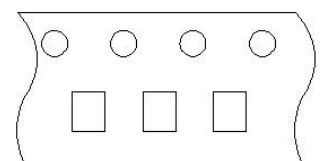
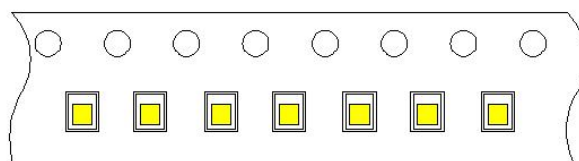
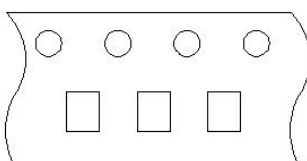


W	8.00±0.10	E	1.75±0.10	P0	4.00±0.10	AO	2.05±0.10	单位
T	0.20±0.05	F	3.50±0.10	P1	4.00±0.10	BO	2.30±0.10	MM
D1	1.10±0.05	DO	1.60±0.05	P2	2.00±0.05	KO	1.00±0.10	



末端

进料方向



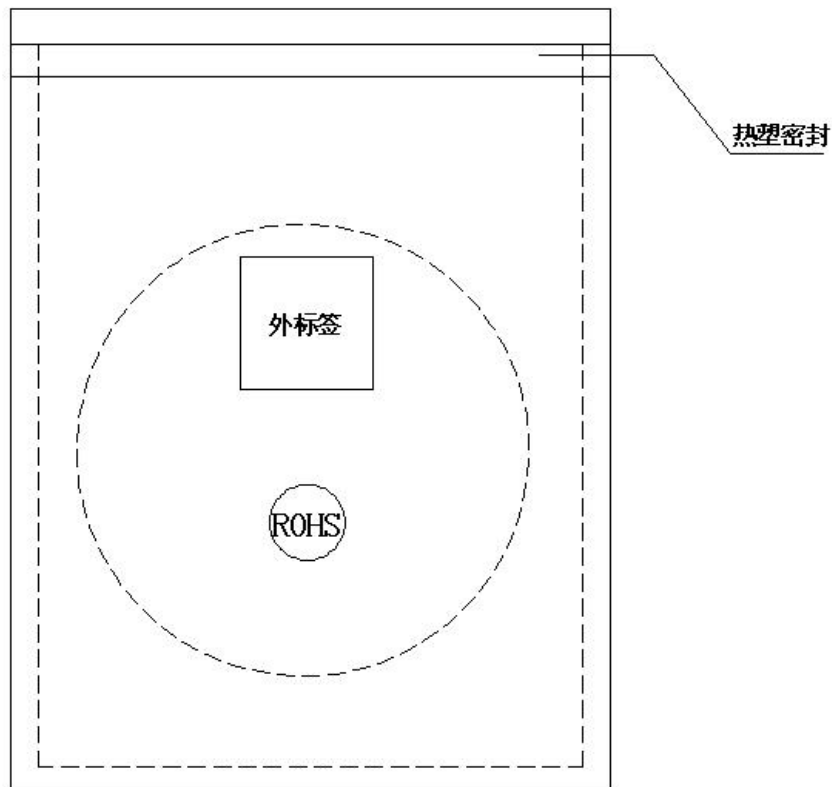
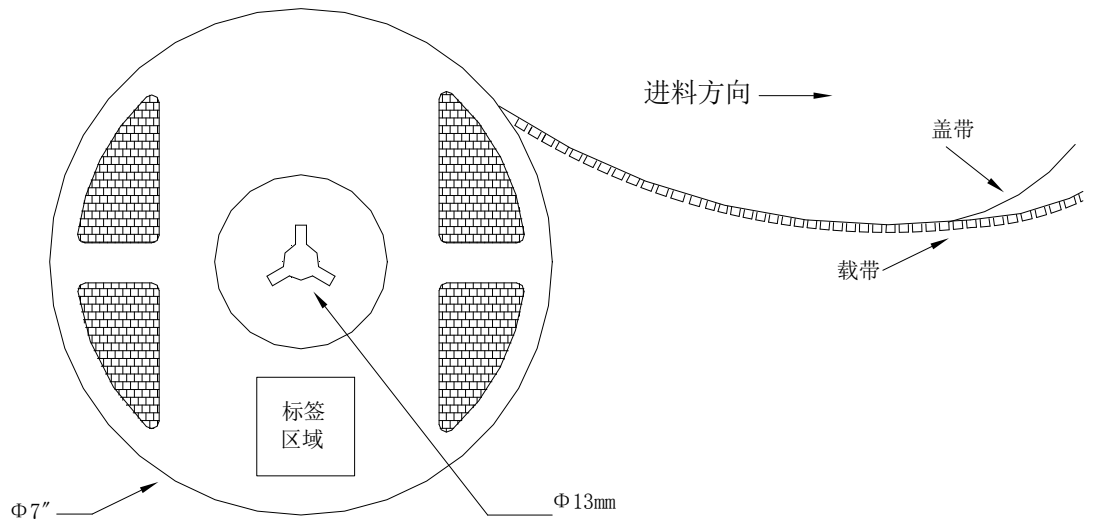
200mm空载带

每卷4000PCS

400mm空载带



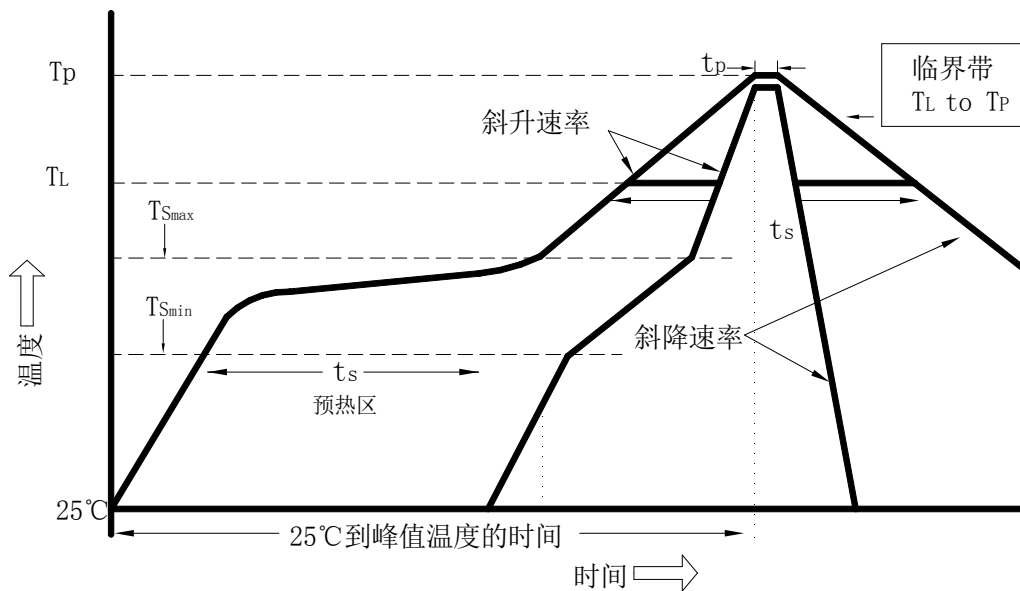
Part No./型号: H2016Y-606A0101-0301QD





Part No./型号: **H2016Y-606A0101-0301QD**

推荐回流焊温度曲线



温度分布特点	无铅焊料
斜升速率 (T _{Smax} 到 T _P)	最大值 3°C/秒
最低预热温度 (T _{Smin})	150°C
最高预热温度 (T _{Smax})	200°C
预热时间 (T _{Smin} 到 T _{Smax})	60-180 秒
液相温度 (T _L)	217°C
温度维持在 T _L 以上时间	60-150 秒
封装体峰值温度 (T _P)	260°C
指定实际峰值温度 5°C 内的时间	20-40 秒
斜率速率 (T _P 到 T _L)	最大值 6°C/秒
25°C 到峰值温度的时间	最大值 8 分钟